

技術詞彙表

於本文件中，除文義另有所指外，本文件中使用與本公司及我們的業務有關的若干詞彙的解釋及定義載於下文。該等詞彙及其涵義未必總是與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

詞彙	釋義
「AGI」	指 通用人工智能
「AGV」	指 自動導引車，一種用於製造及倉儲領域的移動機器人，可沿預設路徑或程序化路線自主運輸物料
「AI」	指 人工智能
「AIDC」	指 人工智能數據中心
「AIO計算機」	指 一體機
「AIoT」	指 人工智能物聯網，即人工智能(AI)與物聯網(IoT)設備的融合，可實現聯網電子設備的智能、情境感知數據處理及自動化操作
「AI PC(s)」	指 人工智能筆記本電腦
「ANC」	指 主動降噪，一種通過產生與噪聲相位完全相反（反相）的聲波來降低不需要的環境噪聲的技術
「AR」	指 增強現實
「ARM」	指 高級精簡指令集計算機
「ARM架構」	指 基於精簡指令集計算原則的中央處理器(CPU)架構家族
「5ATM」	指 五個大氣壓，一種用於描述手錶等可穿戴設備防水性能的等級，表示該設備可以承受相當於水下50米深的靜態水壓
「BOX」	指 電子設備的主要外殼或機箱
「電容器」	指 儲存和釋放電能的電子元件，常用於電路中的電源穩壓及濾波
「腔體天線」	指 一種採用「腔體」結構的緊湊型天線設計，可提升性能並實現小型設備中無線組件的微型化

技術詞彙表

「雲端連接」	指	設備通過互聯網與遠程服務器連接及通信的能力，可實現數據交換、軟件更新或遠程管理
「COB」	指	板上芯片，一種半導體組裝技術，將裸集成電路芯片直接安裝到印刷電路板上，然後採用細導線進行電氣互聯
「CPU」	指	中央處理器，是電子設備中的主芯片，負責通過執行基本算術、邏輯、控制及輸入／輸出操作來運行計算機程序的指令
「CSP」	指	雲服務廠商
「電子電氣架構」	指	產品內部電子與電氣系統的結構化網絡，體現各組件的互聯方式
「EMS」	指	電子製造服務
「FHD」	指	全高清，一種顯示解析度標準，指螢幕解析度為1920×1080圖元的顯示規格
「FOV」	指	視場角，指通過頭戴設備在任意給定時刻可觀察到的環境範圍，以角度為單位進行測量
「FPC」	指	柔性印刷電路，一種電子互連技術，通過在柔性絕緣基材上製作圖案化電路實現信號傳輸
「GPU」	指	圖形處理器，一種專用電子電路，旨在快速操控和修改內存，以加速生成擬在屏幕上輸出的圖像與視頻
「HMI」	指	人機交互界面，供人與機器或計算機交互的界面，如觸摸屏、按鍵或語音控制
「HSF」	指	無有害物質
「Hypervisor 虛擬化架構」	指	通過軟件層實現單個硬件系統運行多個操作系統，支持虛擬化及開發靈活性
「IDH」	指	獨立設計公司
「IP攝像頭」	指	互聯網協議攝像頭，是一種數字視頻攝像頭，通過電腦網絡或互聯網傳輸和接收數據，而非使用傳統的模擬視頻訊號

技術詞彙表

「IPD」	指	集成產品開發，指通過協調製造、工程、技術及產品設計等行業廣泛使用的多個學科及工藝來開發新產品的結構論方法
「IoT」	指	物聯網
「IP65」、 「IP68」、 「IP69」	指	國際防護等級，該等級體系用於評估外殼對固體異物侵入的防護能力
「LCD」	指	液晶顯示器，採用液晶及背光的顯示技術，具有顯示清晰、能效高的特點，廣泛應用於平板、顯示器等電子設備
「LIM」	指	液態射出成型，一種通過液態原材料生產複雜精密零部件的製造工藝
「主從臂結構」	指	一種機器人配置方式，由一個主控制器操控與之匹配的從機械臂，從而實現精準且協同的動作
「MDA」	指	分佈式多天線，一種無線通信架構，在特定區域或設備內，多根天線被部署在不同物理上相互分離的位置
「MR」	指	混合現實，一種擴展現實技術，通過將現實世界與虛擬世界融合，生成全新的環境與可視化效果
「MCU」	指	微控制器單元，一種緊湊型集成電路，旨在控制嵌入式系統中的特定操作
「多麥克風陣列」	指	設備內多個麥克風的組合佈局，可提升音頻採集、聲源定位及降噪效果，對語音助手及耳機至關重要
「NAND」	指	非易失性閃存技術，一種廣泛應用於智能手機等電子設備數據存儲的技術
「NPS」	指	淨推薦值，是一種廣泛應用的指標，用於衡量客戶對某一產品、服務或品牌的忠誠度與滿意度
「ODM」	指	原始設計製造
「OLED」	指	有機發光二極體，一種利用有機材料在通電後發光的平板顯示技術，具有高對比度、廣視角的特點

技術詞彙表

「OWS」	指	開放式音頻技術，一種通過特殊聲學結構將音頻信號定向傳輸至人耳且不會堵塞或完全包裹耳道的技術，尤其適用於超纖薄耳掛及類似可穿戴設備
「PC(s)」	指	個人電腦
「PCB」	指	印刷電路板，通常以玻璃纖維或複合環氧樹脂等絕緣材料為基底，表面蝕刻銅箔形成導電線路的平板基板
「PCBA」	指	印刷電路板組裝，一種將電子元器件安裝並焊接到印刷電路板上所製成的電路板成品
「PDA」	指	個人數字助理，一種手持式電子設備，廣泛應用於工業或零售環境，集計算、掃描與通信功能於一體
「POS終端」	指	銷售點終端
「研發」	指	研究及開發
「RF」	指	射頻
「RISC-V」	指	一種基於精簡指令集計算機架構原則的開放式標準指令集架構
「RTOS」	指	實時操作系統，專為即時數據處理及響應設計的操作系統，對嵌入式系統及關鍵任務電子系統至關重要
「SLAM」	指	即時定位與地圖構建，一種機器人常用算法，能即時繪製周邊環境的地圖，並確定機器人自身的位置，進而實現無需預設路線的高效導航
「小型座艙」	指	一種將導航、媒體、控制及車輛信息整合至屏幕化用戶界面中的數字化集成車載儀表盤
「智能產品」	指	一個行業術語，指集人工智能、物聯網、大數據、通信技術等核心技術為一體，並具有環境感知、數據處理、自主決策、人機交互及執行響應等一項或多項智能功能的產品
「SPK」	指	用於耳機、智能手機、可穿戴設備等電子設備中的微型揚聲器
「TC」	指	碳化鈦

技術詞彙表

「熱節流」	指	電子設備在溫度超過安全閾值時自動降低運行性能
「三層印刷 電路板組件	指	採用三個獨立導電層設計的印刷電路板，各層之間通過絕緣材料層壓而成
「TWS」	指	真無線立體聲，一種無需在左右聲學單元之間使用物理有線連接，而是將音頻信號無線拆分為獨立的左右聲道以實現立體聲效果的無線音頻技術
「UX」	指	用戶體驗
「VC」	指	均溫板，一種薄型平板散熱方案，通過液體蒸發與冷凝快速將熱量擴散到表面
「VMI」	指	越南、墨西哥及印度，指我們在越南、墨西哥及印度的全球製造網絡
「VR」	指	虛擬現實
「Wear OS」	指	一款專為智能手錶等可穿戴設備設計的安卓操作系統版本
「XR」	指	擴展現實，AR、VR、MR等技術的統稱，常用於沉浸式電子產品領域
「x86」	指	一種被廣泛應用的計算機處理器架構